



2026학년도 「글로벌공학설계」 글로벌 대학 연계 반도체 실험·실습 프로그램 참여학생 모집 공고

1. 수업 목표

- 가. 반도체융합전공 참여학생을 대상으로 대만 LHU(Lunghwa University of Science and Technology) 연계 반도체 공정 및 패키징 실습교육을 운영하여 반도체 분야 실무 역량을 강화
- 나. 반도체 제조공정, 패키징 및 테스트 공정 등 현장 중심 실습과 산업체 견학을 통해 글로벌 반도체 산업에 대한 이해를 높이고 진로 탐색 기회를 제공
- 다. 해외 대학 및 산업체 연계 교육 프로그램 참여를 통해 글로벌 반도체 산업 동향을 이해하고 국제적 역량을 갖춘 반도체 전문인재를 양성

2. 「글로벌공학설계」 및 프로그램 개요

○ 2026학년도 하기 계절수업 개요

- 가. 교과목명: 글로벌공학설계(개설: 전북대학교 공과대학)
- 나. 운영기간: 2026학년도 하기 계절수업(2026. 6. 22.(월) ~ 2026. 7. 10.(금))
- 다. 운영장소: 전북대학교 공과대학 8호관 212호
- 라. 강의대상: 반도체융합전공 참여학생
- 마. 담당교수: 김진수 반도체특성화대학사업단장(신소재공학부 정보소재공학 교수)
- 바. 기타사항: 하기 계절수업 기간 중 국내 사전교육 및 이론수업을 운영한 후, 글로벌 대학 연계 반도체 실험·실습 프로그램 참여를 위해 대만 현지 교육과정을 진행
- 사. 참고사항: 글로벌공학설계 교과목은 3학점(이론/실습, 일반선택) 과목이나, 운영 주체인 공과대학의 개설 및 운영 상황에 따라 학점이 변경될 수 있음

○ 실험·실습 프로그램 개요

- 가. 프로그램명: 글로벌 대학 연계 반도체 실험·실습 프로그램
- 나. 프로그램 운영기간: 2026. 7. 5.(일) ~ 2026. 7. 10.(금)





※ 현지 대학 학사일정 및 교육 운영 상황에 따라 2026. 6. 28.(일) ~ 2026. 7. 3.(금) 일정으로 변경될 수 있음

다. 운영장소: 대만 용화과학기술대학교(Lunghwa University of Science and Technology) 및 대만 반도체 산업체·연구기관

라. 강의대상: 전북대학교 반도체융합전공 참여학생 12명

마. 담당교수: 붙임자료 참고

바. 강의주제: 용화과학기술대학교(LHU)와 연계한 반도체 제조공정·패키징 실습 및 대만 반도체 산업체 견학 등 현장 중심 교육 프로그램 운영

사. 이론-실습시간: 40시간(예정)

아. 실습내용: 붙임자료 참고

3. 「글로벌공학설계」 세부 내용

가. 주별 내용

주별	수업일시	수업내용	비고
1주차	2026. 6. 22.	오리엔테이션	
2주차	2026. 6. 23.	글로벌 대학 연계 반도체 실험·실습 프로그램 계획설계	
3주차	2026. 6. 24.	글로벌 반도체 트렌드 특강1	
4주차	2026. 6. 25.	글로벌 반도체 트렌드 특강2	
5주차	2026. 6. 26.	글로벌 반도체 트렌드 특강3	
6주차	2026. 6. 29.	글로벌 반도체 트렌드 특강4	
7주차	2026. 6. 30.	글로벌 반도체 트렌드 특강5	
8주차	2026. 7. 1.	글로벌 대학 연계 반도체 실험·실습 프로그램 사전교육	
9주차	2026. 7. 2.	글로벌 대학 연계 반도체 실험·실습 프로그램 안전교육	

<국내일정>
전북대학교
공과대학 8호관
212호
반도체융합전공
강의실

이론-실습 20시간





주별	수업일시	수업내용	비고
10주차	2026. 7. 5.	「글로벌공학설계」 글로벌 대학 연계 교과목 운영 제목: 글로벌 대학 연계 반도체 실험·실습 프로그램	<국외일정> 대만 용화과학기술대학교 (Lunghwa University of Science and Technology) 이론·실습 40시간
11주차	2026. 7. 6.	1. 주요내용 - 반도체 제조공정 실습	
12주차	2026. 7. 7.	- 반도체 패키징 및 테스트 실습	
13주차	2026. 7. 8.	- 반도체 공정 분석 및 측정 실습	
14주차	2026. 7. 9.	- 반도체 산업체 및 연구시설 견학 - 실험·실습 결과 발표	
15주차	2026. 7. 10.	2 실습일정: 40시간 - 7월 5일 오후(5시간), 7월 6일~9일(각 8시간), 7월 10일 오전(3시간)	

나. 글로벌 대학 연계 반도체 실험·실습 프로그램 운영 계획(안)

- 사업명: 글로벌 대학 연계 반도체 실험·실습 프로그램
- 사업목적: 글로벌 선진 대학 연계 실험·실습 교육 경험을 통해 반도체 선진 기술을 이해하고 활용할 수 있는 글로벌 반도체 전문 인재 육성
- 프로그램 내용: 반도체 제조공정 실습, 반도체 패키징 및 테스트 실습, 반도체 공정 분석 및 측정 실습, 반도체 산업체 및 연구시설 견학
- 운영기간: 2026. 7. 5.(일) ~ 2026. 7. 10.(금), 5박 6일
(※ 현지 대학 학사일정 및 교육 운영 상황에 따라 2026. 6. 28.(일) ~ 2026. 7. 3.(금) 일정으로 변경될 수 있음)
- 참여대학: 전북대학교, 용화과학기술대학교(Lunghwa University of Science and Technology)
- 참여대상: 전북대학교 반도체융합전공 참여학생 12명, 인솔자 1명, 사업단장
- 운영장소: 대만 용화과학기술대학교(Lunghwa University of Science and Technology) 및 대만 반도체 산업체·연구기관
- 운영내용: 용화과학기술대학교(LHU)와 연계한 반도체 제조공정·패키징 실습 및 대만 반도체 산업체 견학 등 현장 중심 교육 프로그램 운영

4. 프로그램 세부 운영 계획(안)

가. 프로그램 일정(안)

- 일시: 2026. 7. 5.(일) ~ 2026. 7. 10.(금), (5박 6일, 변경가능)





- 장소: 대만 용화과학기술대학교(Lunghwa University of Science and Technology) 및 대만 반도체 산업체·연구기관

	1일차	2일차	3일차	4일차	5일차	6일차
	7/5(일)	7/6(월)	7/7(화)	7/8(수)	7/9(목)	7/10(금)
오전	- 공항 이동 - 도착	- 반도체 강의 : Power diode Manufacturing Processes	- 반도체 강의 : Power diode Manufacturing Processes	- 반도체 강의 : Power diode Packaging Processes	- 반도체 강의 : Analysis and Testing	- 반도체 산업체 탐방 - 프로그램 성과 공유 및 현장 견학
오후	- 프로그램 OT 및 안전교육 - 실습 조 편성	- 반도체 제조공정 실습 : Power Diode Manufacturing Processes	- 반도체 제조공정 실습 : Power Diode Manufacturing Processes	- 반도체 제조공정 실습 : Power Diode Manufacturing Processes	- Analysis and Testing - 실습 결과 정리 및 수료식	- 공항 이동 - 귀국

※ 현지 방문 일정에 따라 기업참관 일정은 변동 될수 있음
 나. 프로그램 운영(안)

프로그램명	운영 내용	규모	비고
글로벌 대학 연계 반도체 실습·실습 프로그램	1. 반도체 공정 실습·실습 - 반도체 제조공정 및 공정 장비 이해를 위한 이론·실습 교육 운영 - Photoresist, 노광·현상 등 반도체 제조공정 실습 수행 - Semiconductor Packaging & Test 공정 실습 및 분석 - 반도체 공정 분석 및 측정 실습을 통한 공정 특성 이해 ▶ 반도체 제조공정 및 패키징 공정에 대한 실무 역량 강화	12명(2인 6조) : 실습·실습 활동에 따라 규모 설정하여 운영, + 인솔자 2명(사업단장, 연구원 각 1명)	
	2. 글로벌 대학 네트워킹 - 대만 용화과학기술대학교(Lunghwa University of Science and Technology) 반도체 관련 교수진 및 학생들과의 교류·네트워크 활동 - 글로벌 대학 연계 교육 프로그램 참여를 통한 국제 교류 경험 확대		
	3. 반도체 선진 기업·연구기관 견학 - 대만 반도체 산업체 및 연구기관 견학 운영 - TSMC Innovation Center, 반도체 제조·자동화 관련 산업체(Line Tour) 견학 예정 - 반도체 산업 현장 및 최신 기술 동향 이해를 위한 현장 중심 교육 운영		





다. 실험·실습 교육 운영(안)

- 프로그램: 반도체 제조공정 및 패키징 실습·실습 교육

- 프로그램 목적

: 반도체 제조공정 및 패키징 공정에 대한 이론과 실습 교육을 통해 반도체 공정의 원리와 공정별 특성을 이해하고, 현장 중심 실습을 기반으로 반도체 분야 실무 역량을 강화

- 프로그램 실험·실습 운영 개요

1) 반도체 제조공정 실습

- o Photoresist coating 및 노광·현상 공정 실습
- o 반도체 제조공정 장비 이해 및 공정 실습 수행
- o 반도체 8대 공정 및 공정 흐름 이해

2) 반도체 패키징 및 테스트 실습

- o Semiconductor Packaging & Test 공정 실습
- o Die Bonding, Wire Bonding 등 패키징 공정 실습
- o 반도체 패키징 공정 및 테스트 공정 이해

3) 반도체 공정 분석 및 측정

- o 반도체 공정 분석 및 측정 장비 활용 실습
- o 공정 특성 분석 및 결과 데이터 확인
- o 공정별 특성 비교 및 결과 정리

5. 지원사항 및 협의사항

○ 참여학생 지원사항

- 지원내용: 항공료, 숙박비, 식비, 현지 이동 및 교통비, 실습 재료비, 장비 및 공간 사용료, 입장료, 여행자보험 등 프로그램 운영 관련 비용 지원
- 지원불가: 여권 발급비 및 개인 경비(용돈, 기념품 구입 등)
- 실험·실습 교육 참여를 위한 개인 휴대용 기기(노트북, 태블릿PC 등) 개별 지참 권장

6. 참여학생 선발

가. 선발 인원: 12명(총 6팀, 1팀당 2명으로 구성)

나. 신청 대상: 반도체융합전공 참여학생(※ 공고일 기준 유예자 및 졸업예정자 제외)

다. 선발 절차





- 1) 서류심사(30점) : 담당 실무자 평가 후 보고
 - 가) 성적 우수자
 - 나) 글로벌 대학 연계 반도체 실험·실습 프로그램 운영에 따른 활동계획서
 - 다) 사업단 마일리지 취득 점수
- 2) 면접심사(70점) : 심사위원 평가
 - 신청 팀별 PT 발표에 대한 면접 평가(10분 이내, 팀 구성원 전원 참석)
 - 신청 동기, 프로그램 주제에 대한 이해도, 활동 계획의 구체성 및 적극성, 팀별 역할 분배와 참여도, 향후 활동 및 진로 계획 등 정성평가
 - 필요시 외국어(영어 또는 중국어) 성적 보유 확인 및 면접 심사에서 외국어 발표를 진행하여 심사 결과에 반영할 수 있음
- 3) 심사기준(안)

구분	평가항목	배점	점수	비고
서류심사 (정량)	1) 성적 우수자	10	30	* 심사 점수가 동점일 경우, 팀 구성원 전체 성적의 평점 평균 점수가 우수한 팀을 선발 * 교과목 및 프로그램은 2026년도의 참여 실적을 팀별 평균 산출 * 팀 구성원 전원이 발표해야 하며, 발표 결과 이후 서류 심사 점수를 종합하여 선발 여부 최종 결정
	2) 활동계획서 및 구비서류 준비도	10		
	3) 교과목 및 프로그램 참여 횟수	10		
면접심사 (정성)	1) 신청 동기	10	70	
	2) 프로그램 주제에 대한 이해도	10		
	3) 활동 계획의 구체성 및 적극성	10		
	4) 팀별 역할 분배 및 참여도	10		
	5) 향후 활동 및 진로 계획	10		
	6) 발표 자세 및 태도	20		
합계			100	

라. 신청 방법

- 1) 팀 구성: 1팀당 2명으로 구성
 - * 신청 후 구성원 변경 불가, 변경시 취소 후 차순위 팀 선발
- 2) 제출서류 목록
 - 신청서류를 구비하여 사업단 담당자 E-mail로 제출
(심규현 선임연구원, sgh4315@jbnu.ac.kr)
 - 메일제목: 2026년 반도체신사유람단_글로벌공학설계 신청_팀명_팀장명





구분	제출서류	비고
신청 시	참가신청서	<서식1>
	활동계획서	<서식2>
	개인정보수집·활용동의서	<서식3>
	어학증명서 사본	보유시 제출(영어, 중국어 등), 공고일 기준 2년 이내 취득만 인정
	성적증명서	2026.03.01. 이후 발급분만 인정
	재학증명서	2026.03.01. 이후 발급분만 인정
서류 합격 후	발표자료	5분 이내 발표, 자유양식
	여권사본	출국일 기준 여권 만료일 6개월 이상
선정 후	서약서	<서식4>, 선정자 대상 추후 안내
	보호자 동의서	<서식5>, 선정자 대상 추후 안내
활동 이후	실험·실습 활동보고서	<서식6>, 선정자 대상 추후 안내

※ 제출 서류는 한 번에 스캔하여 PDF 파일 1개로 제출(발표자료만 별도 제출)

※ 발표자료 파일명: 2026년 글로벌공학설계 발표 자료_팀명_팀장명 (ppt, pdf 등으로 제출)

마. 선발 일정

구분	기간	내용
신청 서류 접수	2026. 5. 29.(금)~ 6. 2.(화) 9시까지	- 사업단 담당자 E-mail 제출, 시간 엄수
서류심사	2026. 6. 2.(화)	- <서식7>의 서류심사 기준에 따라 담당자 정량평가 진행
서류심사 합격자 발표	2026. 6. 2.(화)	- 사업단 홈페이지 공지 및 개별 통보
발표자료 제출	2026. 6. 8.(월) 18시까지	- 사업단 담당자 E-mail 제출
면접심사	2026. 6. 9.(화) 18시~	- PT 발표 및 면접심사 진행 - 심사 일시 추후 확정하여 공지
최종 합격자 발표	2026. 6. 10.(수)	- 사업단 홈페이지 공지 및 개별 통보
계절학기 신청	2026. 6월 중	- 계절학기 개설 요청 및 수강학생 확정





오리엔테이션	2026. 6월 중	- 주요사항 및 하기 계절학기 운영 안내
프로그램 활동 참여	2026. 7. 5.(일) ~ 2026. 7. 10.(금)	- 대만 용화과학기술대학교(LHU) 글로벌 대학 연계 반도체 실험·실습 프로그램 운영
결과보고	프로그램 종료 후 3일 이내	- 활동보고서 및 참여수기 제출
계절학기 교과목 평가 및 학점 부여	2026. 7.	- 계절학기 수업 운영 및 평가로 학점 취득 - 학점은 공과대학 개설 기준에 따름(P/F)

※ 위 일정은 사업단 운영 상황에 따라 변동 가능

바. 신청 학생 유의사항

- 1) 해당 계획은 2026학년도 하기 계절수업 「글로벌공학설계」에 반드시 참여 가능한 학생만 선발이 가능하므로, 해당 계절수업 및 해외 프로그램 전 일정에 참여 가능한 학생만 신청 가능
 - ※ 하기 계절수업 「글로벌공학설계」(일반선택)는 공과대학을 통해 개설되며, 계절학기 신청은 본 프로그램에서 선발된 학생들을 대상으로 반도체특성화대학사업단에서 지원함
 - ※ 하기 계절수업 기간 동안 글로벌 대학 연계로 해외에서 프로그램이 진행되기 때문에 다른 계절수업의 참가가 불가함
- 2) 2026학년도 하기 계절수업에서 운영된 「글로벌공학설계」를 신청한 적이 없어야 하며, 이전 참가했던 경력이 있을시 신청 자격이 상실됨
- 3) 신청자는 제출서류를 누락 없이 제출하여야 하며, 사업단 요청 시 활동보고서, 참여수기, 성과보고 등 관련 자료 제출에 성실히 응하여야 함
- 4) 면접심사 이전까지 여권 사본을 제출하여야 하며, 여권 만료일은 출국일 기준 6개월 이상 남아 있어야 함
- 5) 지원자는 공고 및 유의사항 미숙지로 인해 발생하는 불이익이 없도록 내용을 꼼꼼히 확인한 후 신청해야 함
- 6) 본 프로그램의 강의 및 실험·실습은 전 일정 영어로 진행되므로, 신청자는 프로그램 참여에 참고하여야 함
 - ※ Factory Line Tour 시 통역 지원될 수 있음
- 7) 다음 사항에 해당되는 경우임에도 신청한 경우는 참가 자격 박탈 및 위약금이 부과될 수 있으므로 자격 확인 후 신청해야 함





- 휴학, 자퇴, 취업 등 재학생 신분을 포기하였을 경우
- 개인적인 사정으로 프로그램 참가를 포기하였을 경우
- 신청 서류의 내용이 사실과 다른 경우
- 프로그램 진행 과정 전체에 불성실하게 임할 경우
- 제출서류를 기한 내 제출하지 않을 경우
- 프로그램 중 무허가 개인 활동으로 인해 문제가 발생한 경우

사. 특혜사항

- 「글로벌공학설계」 교과목을 이수(Pass)시 일반선택 학점 인정
- 용화과학기술대학교(LHU) 연계 반도체 공정·패키징 실습 프로그램 수료증 (LHU 총장 명의) 발급 예정
 - ※ 수료증 발급 여부 및 수료 시간은 현지 대학 협의 결과에 따라 변경될 수 있음
- 반도체 제조공정, 패키징 및 테스트 등 반도체 제작 전 과정 제작실습 진행
- 마일리지 30점 부여

아. 신청문의

- 전북대학교 반도체특성화대학사업단 선임연구원 심규현(063-219-5770)

